



# 8440 HS

## 제품 정보

40µm 반투명 HAF 마운팅 테이프

## 제품 설명

tesa® HAF 8440은 열가소성 코폴리이미드가 들어간 열활성 양면 반투명 접착 필름입니다.

### 특성:

- 안정적인 칩 모듈에의 점착력
- PVC, ABS, 폴리카보네이트 카드에 적합
- 일반적인 삽입 공정에서의 우수한 작업성
- 우수한 내후성
- 조립된 카드에서는 보이지 않음

## 특성

- 안정적인 칩 모듈에의 점착력
- PVC, ABS, 폴리카보네이트 카드에 적합
- 일반적인 삽입 공정에서의 우수한 작업성
- 우수한 내후성
- 조립된 카드에서는 보이지 않음

## Applications

tesa® HAF 8440은 스마트 카드에 칩 모듈을 삽입하는 용도로 설계된 제품입니다.

## Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

## 제품 구조

- |          |       |          |       |
|----------|-------|----------|-------|
| • 기재 소재  | 없음    | • 이형지 종류 | 글라신지  |
| • 접착제 종류 | 혼성중합체 | • 총두께    | 40 µm |

## 속성 / 성능 값

- 점착력 12 N/mm<sup>2</sup>

## 추가정보

### Technical Recommendations:

The following values are recommendation for machine parameters to start with. Please note that optimum parameters strongly depend on the type of machine, particular materials for card bodies and chip-modules as well as customer requirements.

관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=08440>



# 8440 HS

## 제품 정보

## 추가정보

### 1. Pre-lamination:

During pre-lamination, the adhesive tape is laminated onto the module belt. This step can be performed inline or offline. The pre-lamination step does not effect the shelf life time of the adhesive tape.

#### Machine setting:

\* Temperature 130 - 140 °C

\* Pressure 2 - 3 bar

\* Time 2.5 m/min

### 2. Module Embedding:

During module embedding, the pre-laminated modules are die cut from the module belt, positioned into the card cavity and permanently bonded to the card body by heat and pressure. For this step, the exact handling depends on the type of the implanting line used. Single step and multiple step can be used. Today, multiple step is common:

#### Single step process - Machine setting :

\* Temperature<sup>1</sup> 180 – 220 °C

\* Pressure 65 - 75 N/module

\* Time 1.5 s



# 8440 HS

## 제품 정보

### 추가정보

Multiple step process (2 or more heating stamps) - Machine setting:

\* Temperature<sup>1</sup> 180 – 220 °C

\* Pressure 65 - 75 N/module

\* Time 2 x 0,7 s. /3 x 0.5 s

<sup>1</sup> Temperature as measured inside the heating stamp. Different temperature settings are recommended for different card material:

\*PVC 180 - 190 °C

\*ABS 180 - 190 °C

\*PC 200 - 220°C

For applicants other than chip module implanting, different machine parameters should be used.

Bonding strength values were obtained under standard laboratory conditions. Value is guaranteed clearance limit checked with each production batch (Material: Etched aluminium test specimen / Bonding conditions: Temp. = 120 °C; p = 10 bar; t = 8 min)

Storage conditions according to tesa HAF® shelf life concept.



# 8440 HS

## 제품 정보

### 공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=08440>